

## Groupe : [Stacking Puces]

### Missions :

- Evaluer les méthodes d'analyses de localisation de défauts sur des composants en structure 3D.
- Identifier les technologies d'empilements 3D existantes
- Se focaliser sur 2 ou 3 problématiques communes aux participants du groupe.

### Objectifs :

- 1/ Problématique de préparation d'échantillon => Comment avec dans un premier temps, des techniques simples, rapides et peu coûteuses réaliser des Xsections dans des systèmes 3D sans générer de délamination ou fissure par le process de préparation.
- 2/ Comment mesurer l'impact thermique d'une puce stackée sur une autre. Limites techniques ? Précision des mesures? Mise en œuvre? ...